

Technische Information - Nr.: CCII-79-01

Durch diese Produktgruppen-Information bestätigen wir, BOPLA Gehäusesysteme GmbH, dass die nachstehend aufgeführten Eigenschaften der Produktgruppe entsprechen.

Produktgruppe: **CombiCard 5000-7000**

Schutzart nach DIN EN 60529: bis IP 66 je nach Ausführung
IP 30 Lüftungsvarianten

Materialverwendung

Gehäuseteile	ABS
glasklarer Deckel	Polycarbonat
Frontplatten	Aluminium
Montage-/Trennplatten	Hartpapier

Materialeigenschaften

Wärmeformbeständigkeit A (ISO 75)	80 °C
Brennbarkeit (UL 94)	HB

Bestätigte Standards

RoHS
REACH

Sonstige Hinweise

Die Wärmeformbeständigkeit eines Gehäuses ist auch abhängig von einer eingelegten Dichtung.
Weiterhin können die Temperaturgrenzen durch mechanische Beanspruchung beeinträchtigt werden.
Die aufgeführten Eigenschaften wurden an genormten Prüfkörpern ermittelt.

Die Angabe von technischen Informationen erfolgt nach bestem Wissen, befreit den Anwender aber nicht von der Prüfung der Eignung dieser Angaben für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.